

## 导热抗静电无玻纤硅胶 XK-ACA

### 简介

热压着缓冲垫，主要应用在 LCD module(OLB、PCB)制程上，作为异方性导电膜(ACF)的热压着缓冲使用，目的在将热压头之高温传导至 ACF 使其软化固化并产生黏着效果，以及作为热压头的接触缓冲材料



### 特性

- 优异耐热、抗静电
- 耐久性、导热性好
- 离型性佳、表面洁净平整

### 应用

- 主要取代富士高分子 CSWE
- 主要应用于显示屏产业，产品主要包括 OLED, LCD display, LCD TV 等。

Property	unit	XK-ACA	method
Color 颜色		black	visual
Thickness 厚度	mm	0.2mm 以上	ASTM D374
Density 密度	g/cm <sup>3</sup>	1.4	ASTM D792
Hardness 硬度	Shore A	80	ASTM D2240
Application temperature(long term) 长期耐温	℃	-60~250	-
Application temperature (short term) 瞬间耐温	℃	-60~400	-
Tensile Strength.抗张强度	Psi	>400	ASTM D412
Tear-strength 抗撕强度	N/mm	>10	ASTM D624
Elongation 伸长率	%	50~100	ASTM D412
Total mass loss 重量损失	%	<0.5	ASTM E595
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown 耐电压	KV/mm	-	ASTM D149
Volume resistivity 体积电阻	Ohm	10 <sup>3</sup>	ASTM D257
THERMAL			
Thermal Conductivity 导热系数	W/m*K	0.8	Hotdisk